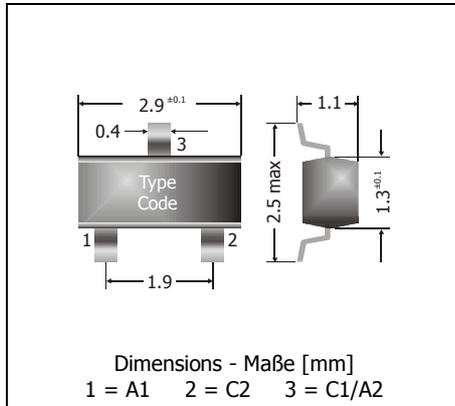


## BAV199

### Surface Mount Low Leakage Double-Diodes Doppel-Dioden mit niedrigem Sperrstrom für die Oberflächenmontage

Version 2012-09-03



Power dissipation – Verlustleistung	250 mW
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	85 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	SOT-23 (TO-236)
Weight approx. – Gewicht ca.	0.01 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	



#### Maximum ratings (T<sub>A</sub> = 25°C)

#### Grenzwerte (T<sub>A</sub> = 25°C)

per diode / pro Diode		BAV199	
Power dissipation – Verlustleistung <sup>1)</sup>		P <sub>tot</sub>	250 mW <sup>2)</sup>
Max. average forward current – Dauergrenzstrom (dc)		I <sub>FAV</sub>	140 mA <sup>2)</sup>
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom		I <sub>FRM</sub>	500 mA <sup>2)</sup>
Non repetitive peak forward surge current Stoßstrom-Grenzwert	t <sub>p</sub> ≤ 1 s	I <sub>FSM</sub>	0.5 A
	t <sub>p</sub> ≤ 1 ms	I <sub>FSM</sub>	1 A
	t <sub>p</sub> ≤ 1 μs	I <sub>FSM</sub>	4 A
Repetitive peak reverse voltage – Periodische Spitzensperrspannung		V <sub>RRM</sub>	85 V
Reverse voltage – Sperrspannung (dc)		V <sub>R</sub>	85 V
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T <sub>j</sub>	-65...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T <sub>S</sub>	-65...+150°C

#### Characteristics (T<sub>j</sub> = 25°C)

#### Kennwerte (T<sub>j</sub> = 25°C)

Forward voltage Durchlass-Spannung	I <sub>F</sub> = 1 mA	V <sub>F</sub>	< 900 mV
	I <sub>F</sub> = 10 mA	V <sub>F</sub>	< 1 V
	I <sub>F</sub> = 50 mA	V <sub>F</sub>	< 1.1 V
	I <sub>F</sub> = 150 mA	V <sub>F</sub>	< 1.25 V
Leakage current <sup>3)</sup> Sperrstrom	T <sub>j</sub> = 25°C V <sub>R</sub> = 75 V	I <sub>R</sub>	< 5 nA
	T <sub>j</sub> = 150°C V <sub>R</sub> = 75 V	I <sub>R</sub>	< 80 nA

1 Total power dissipation of both diodes – Summe der Verlustleistungen beider Dioden

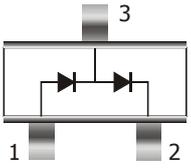
2 Mounted on P.C. board with 3 mm<sup>2</sup> copper pad at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss

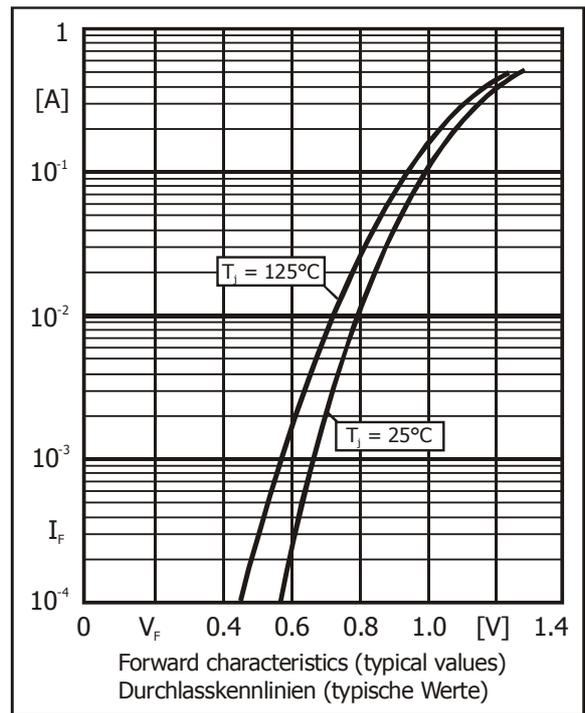
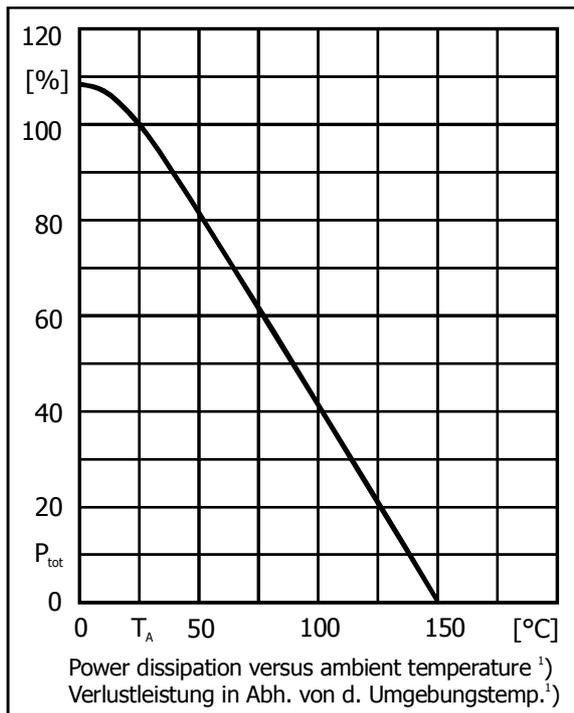
3 Tested with pulses t<sub>p</sub> = 300 μs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen t<sub>p</sub> = 300 μs, Schaltverhältnis ≤ 2%

**Characteristics (T<sub>j</sub> = 25°C)**

**Kennwerte (T<sub>j</sub> = 25°C)**

Max. junction capacitance – Max. Sperrschichtkapazität V <sub>R</sub> = 0 V, f = 1 MHz	C <sub>T</sub>	2 pF
Reverse recovery time – Sperrverzug I <sub>F</sub> = 10 mA über/through I <sub>R</sub> = 10 mA bis/to I <sub>R</sub> = 1 mA	t <sub>rr</sub>	< 3 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft	R <sub>thA</sub>	< 500 K/W <sup>1)</sup>

Pinning – Anschlussbelegung		Marking – Stempelung
	Double diode, series connection Doppeldiode, Reihenschaltung  1 = A1    2 = C2    3 = C1/A2	BAV199 = PX



<sup>1</sup> Mounted on P.C. board with 3 mm<sup>2</sup> copper pad at each terminal  
 Montage auf Leiterplatte mit 3 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss